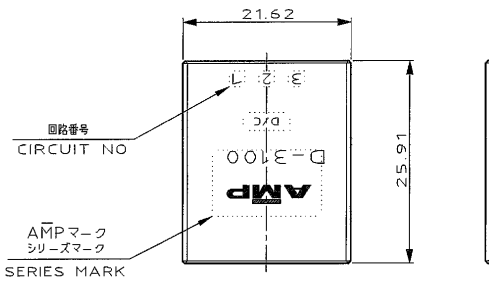

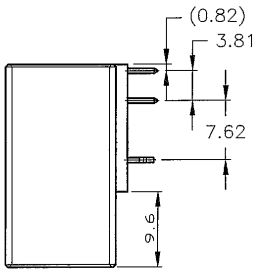

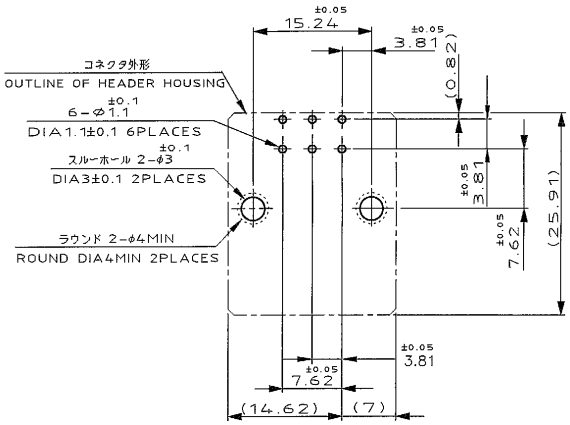

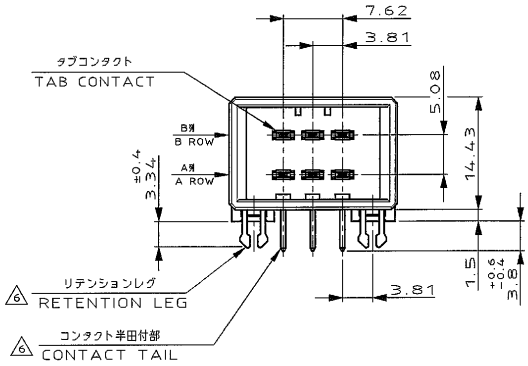

推奨基板取付け穴寸法
PC 基板厚:1.6±0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN
PC BOARD THICKNESS:1.6±0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES
1. MATERIAL:HOUSING:GLASS FILED THERMO PLASTIC,POLYESTER
CONTACT:COPPER ALLOY
RETENTION LEG:COPPER ALLOY
2. FINISH(CONTACT AREA):0.38μmMIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
3. FINISH(CONTACT AREA):0.76μmMIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
4. FINISH(CONTACT AREA):2.0 μmMIN TIN PLATED OVER NICKEL
~~5. FINISH(RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL~~
6. FINISH(RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記
1. 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
2. めっき: コンタクト: 全面Ni下地 接触部:0.38μm MIN金めっき
3. めっき: コンタクト: 全面Ni下地 接触部:0.76μm MIN金めっき
4. めっき: コンタクト: 全面Ni下地 接触部:2.0 μm MINスズめっき
~~5. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部 : ニッケル下地の上に半田めっき~~
6. めっき リテンションレグとコンタクト半田付部 : ニッケル下地の上にスズめっき

6 4	178303-5
6 3	178303-3
6 2	178303-2
(FINISH)	製品番号 (PART NO.)

LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE
C	REVISED(FJD0-0039-03)	T.S	S.M	4/15 '03
B	REVISED(FJD0-0097-03)	T.S	S.M	3-33 '95
A	REVISED (FJ00-2183-95)	K.I	S.M	3-33 '95
0	RELEASED (J-1184)	N.M	H.O / S.M	3-4 '92

Copyright © 1991
AMP(Japan) LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.

tyco Electronics
Tyco Electronics AMP K.K
Kawasaki,Japan

WIRE RANGE	INSULATION DIA
mm²(AWG)	mm
MATERIAL SEE NOTE 注記参照	FINISH SEE NOTE 注記参照
DR. N.Matsubara 14 JUN 91	DE. N.Matsubara 14 JUN 91
CHK. K.Ogata 26/FEB/92	APP. S.MIYABE 6/MAR/92

NAME ダイナミック D3100 水平タイプ 6 極 ヘッダーアセンブリー
6 POS DOUBLE ROW HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC 3100

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)
10以下 ±0.3
10を超え30以下 ±0.4
30を超え100以下 ±0.45
角度 ±3°

SIZE	LOC	NUMBER
A3	J	C-178303

SCALE	REV.	SHEET
2-1	C	1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面

METRIC | NUMBER 178303 | 3rd ANGLE PROJECTION
DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT
PRINT DIST
AMP-J REV.10/'83

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor